SEMICONDUCTOR LASER

Patent number:

JP10004237

Publication date:

1998-01-06

Inventor:

WADA MITSUGI

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

H01S3/18

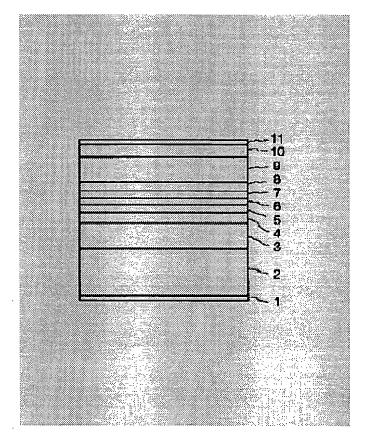
- european:

Application number: JP19960155691 19960617

Priority number(s):

Abstract of JP10004237

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the reliability of a semiconductor laser under high output oscillation in a strain quantum well semiconductor laser 0.90-1.1&mu m. SOLUTION: An n-Inx4 Ga1-x4 As1-y4 Py4 clad layer 3, an Inx3 Ga1-x As1-y Py light guide layer 4, an Inx2 Ga1-x2 As1-y Py tension strain barrier layer 5, an Inx1 Ga1-x As1-y Py compression strain active layer 6, an Inx2 Ga1-x As1-y Py tension strain barrier layer 7, an p-lnx3 Ga1-x3 As1-y3 Py3 light guide layer 8, an p-Inx4 Ga1-x4 As1-y4 Py4 clad layer 9 and an p-GaAs contact layer 10 are successively grown on an n-GaAs substrate 2. In such a constitution, the barrier layers 5, 7 have the tension strain of the strain amount compensating the compression strain of the active layer 6. Furthermore, the clad layer 3, 9 and the light guide layers 4, 8 are composed to be lattice-matched with the substrate 2.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

ව

である。111 族原料となる有機金属として、トリメチル ガリウム (TMG) およびトリメチャインジウム (TM に、n-Inx4Gal-x4Asl-y4Py4クラッド闘3(0≦x4≦1, 0 ≦y4≦1)、Inx36a1-x3As1-yPy光導故醫 4 (x2≤x3≤0.2 1)を用い、V 族原料となる水鞣化物ガスとしてAsH3、 PH3を用いるMOCVD装配によりn-GaAs 基板2上

|-y4Py4 クラッド暦9、p-GaAsコンタクト暦10を順次成 長させる。なお、相成の範囲は図2の組成図を用い、70 0 ℃で成長する際のミシアリティギャップを地値して定 番6(0≦x1≦1)、Inx2Gaj-x2Asj-yPy引班り歪障監層 7、lnx3Gal-x3Asl-yPy光導故醫 8、p-lnx4Gal-x4As

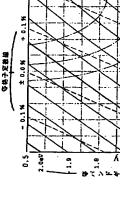
井戸活性層6の圧縮歪を補償するように設定する。この 【0012】クラッド磨3、9および光導故隔4、8は GaAs芸板2に格子整合する組成とする。最子井戸活性層 6の預を補償する引張り預障監備5、7の厚みは結晶成 頭、光導液偏と引張り鱼障腔隔で∨核のAs、P の組成が 同じであるから、MOCVD成長においてそれぞれの原 ために、安定に各ヘテロ界面を形成することが可能とな **費中に転位等の欠陥を発生させない厚みに散定し、引張** り 頚陣盤層5、7の魚畳は、活性層6を挟む2層で畳子 科となるAsH3、PH3 のV該原料を切り換える必要がない

[0013] その後に基板2とコンタクト暦10とのそれ ぞれに金属電極1、11を形成した半導体ワーザを完成す

[0014]上配実施の形態では、単純なダブルヘテロ

構造の形成のみ記載しているが、これらの構成に通常の

[図]



フォトリングラフィーやエッチングによる加工を行い屈 **所率導液機構付き半導体レーザ、回折格子付きの半導体** レーザや光集徴回路の作製にも用いることが可能であ

造を示したが、S Q Wの代わりに畳子井戸を複数とする で、光導液隔組成が一定のSQW-SCHと呼ばれる構 【0015】上配実施の形態では特に量子井戸が単一 MQWであってもよい。

5. 0.04≦y≦0.50)、Inx2Gal-x2Asl-yPy引張り歪阵監局

5 (x2≤x3≤0.25) 、InxJGal-xJAs圧縮鈕最子井戸括性

[0016]また、発板する校長帯に関しては、前記In 【0017】また、クラッド蜀の組成はGaAsに格子整合 xlGal-xlAs活性層により、900nm < 1 < 1100nmの範囲ま **するInGaP あるいはAlGaAsでもよい。なお、成長法とし** C、固体あるいはガスを原料とする分子線エピタキシャ での制御が可能である。

小成長社を用いてもよい。

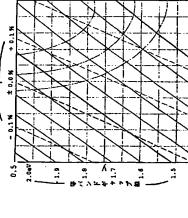
|図1||本発明の半導体レー扩操子断面観略図 図面の簡単な説明】

ハーInx46al-x4Asl-y4Py4 クラッド層 nx3Gal-x3Asl-yPy 光導故層 n-CaAs基板 n侧电極 符号の説明】

nxIGal-xiAsl-yPy 压缩歪盘子并戸话性層 nx2Ga1-x2As1-yP,引張り盃障壁層 nx2Gal-x2Asl-yPy 引張り歪障壁層 p-Inx4Gal-x4Asl-y4Py4 クラッド層 Inx3Ga1-x3As1-yPy 光導故層

p-GaAs コンタクト幅

[図2]



700 T

InxGa1-xAs_{1-y}Py

[手続補正魯]

[提出日] 平成8年8月20日 [手続補正1]

|補正対象曹類名||明細曹

[補正対象項目名] 図面の簡単な説明

[補正方法] 追加

[図面の簡単な説明] [補正内容]

[図1] 本発明の半導体レー扩繋子断面概略図

[図2] 半導体原料の組成図 【符号の説明】

n個電極

3

n-Inx4Gal-x4Asl-y4Py4 クラッド喝 Inx3Gal-x3As1-yPy 光導液層

n-GaAs基板

InxIGal-xIAsl-yPy 压相歪盘子并戸话性圈 Inx2Gal-x2Asl-yPy 引張り歪障壁層

Inx2Ga1-x2As1-yPy 引張り歪降壁層

P-Inx4Gal-x4Asl-y4Py4 クラッド扇 Inx3Gal-x3Asl-yPy 光導夜層

p-CaAs コンタクト圏

の意館を

(19)日本国特許庁 (JP)

公開特許公報(A)

<u>8</u>

(11)特許出願公開番号

特開平10-4237

(43)公開日 平成10年(1998) 1月6日

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

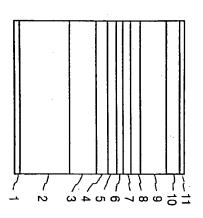
(21)出願書号 特顧平8-155691 (71)出願人 00005201 富士写真フイルム株式会社 存糸川県南足柄市中宿210番地 (72)発明者 和田 頁 神糸川県足柄上部開成町 宮台759番地 富士写真フイルム株式会社内 (74)代理人 弁理士 柳田 征史 (外1名)

(54) [発明の名称] 半導体アーカ

(57)【烟莎】

【課題】 0.90-1.1μm 帯の蚕量子井戸半導体レーザに おいて、高出力発版下における信頼性を向上させる。

【解決手段】 n-GaAs基板2上に、n-In_{Xd}Ga_{1-X}As_{1-y}4 P₂₄ クラッド層 3、In_XGa_{1-X}3As_{1-y}P_y光導故層 4、In xGGa_{1-X2}As_{1-y}P_y 引張り蚕体盤層 5、In_XIGa_{1-X}1As_{1-y}P y 圧縮室活性層 6、In_XGa_{1-X}2As_{1-y}P_y引張り蚕体盤層 7、p-In_XGa_{1-X}3As_{1-y}3P_y3光導故層 8、p-In_XGa_{1-X}A s_{1-y4}P_{y4} クラッド層 9、p-GaAs コンタクト層 10を順次 成長させる。傾壁層 5、71式、活性層 6 の圧縮室を補償 する蚕量の引張り蚕を有する。なお、クラッド層 3、9 および光導波層 4、8 は基板 2 に格子整合する組成である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 III-V族化合物半導体であるGavs基板上に少なへとも第一クラッド層、第一光導液層、第一障壁層、活住層、第二障壁層、第二光導液層および第二クラッド層を順次積層させて形成するIII-V族系半導体レーデにおいて、

前記第一および第二クラッド層と前記第一および第二光導改層とが前記GaAs基板に格子整合する組成からなり、前記活性層が前記GaAs基板に対して圧縮性歪を生じる組成からなり、

前記第一および第二陣壁層、前記活性層の前記圧箱性蚕を補償するため引張り蚕を生じる組成からなり、

前記第一光導液層と第一障壁層、および第二光導液層と 第二障壁層のV族組成比が同一であることを特徴とする III-V族系半導体レーチ。

【請求項2】 前記活性層の組成を $\ln_\chi 1Ga_{1-\chi}1As(0 \le x)$ $\le 1)$ とし、前記第一および第二歪障壁層を $\ln_\chi 2Ga_{1-\chi}2As_{1-\gamma}P_\gamma(0.00 \le x2 \le 0.23, 0.04 \le y \le 0.50)$ とし、前記第一 および第二光導板層を $\ln_\chi 2Ga_{1-\chi}2As_{1-\gamma}P_\gamma(x2 < x3 \le 0.25)$ とすることを特徴とする請求項1記載の111 - V 族系半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザに闘するものであり、特にIII-V族系半導体レーザの組成に関するものである。

[0002

【従来の技術】従来、 0.98μ m帯の半導体レーザとして Appl. Phys. Lett., 62(1993) 1644に開示されているような n-GaAs聶板にn-InGaP クラッド層、 $In_{\chi3}$ Ga $_{1-\chi3}$ As $_{1-\chi3}$ Py 光導液層、 $GaAs_{1-\chi2}$ Py 月頭 五輝壁層、 $In_{\chi1}$ Ga $_{1-\chi1}$ As圧縮至量子井戸層、 $GaAs_{1-\chi2}$ Py 月頭 五輝壁層、 $In_{\chi3}$ Ga $_{1-\chi3}$ Py 五輝壁層、 $In_{\chi3}$ Ga $_{1-\chi3}$ Py 五輝壁層、 $In_{\chi3}$ Ga $_{1-\chi3}$ Py 五輝度層、 $In_{\chi3}$ Ga $_{1-\chi3}$ Py 3光導液層、p-InGaPグラッド層、p-GaAs $_{1-\chi3}$ Py 7層を積層してなる半導体レーザが提案されている。

0000

【発明が解決しようとする課題】しかし上述の構造では有機金属気相成長(MOCVD) 法における結晶成長において、光導液層から引張り歪瘫壁層、あるいはそれらの逆の成長過程において、V族水素化物ガス (Ptg. Ash の の切換時にPとAsの急激な置換が生じ結晶表面の状態を不安定にしてしまうため、各層間の界面を高品質で安定に再現性良くつくることができず、また、界面の上に成長する結晶の品質を落としてしまうという欠点がある。

[0004]本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、高出力発版下においても信頼性の高いの、9-1.1μm帯の強量子井戸型のIII-V版系半導体レーザを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】本発明の111-V炭系半導体レーザは、111-V炭化合物半導体であるGaAs 苗板上に少なくとも第一クラッド層、第一光導液層、第一偏壁層、活性層、第二障壁層、第二光導液層はよび第二クラッド層を順決積層させて形成する111-V炭系半導体レーザにおいて、前記第一および第二クラッド層と前記第一および第二光導液層とが前記GaAs 苗板におして圧縮性最からなり、前記活性層が前記GaAs 苗板に対して圧縮性最を生じる組成からなり、前記済生活が第二光導液層と対前記GaAs 苗板に対して圧縮性でを生じる組成からなり、前記済生物が開大等一種壁層、および第二光導液層と第二体壁層でするため引扱り強を生じる組成がらなり、前記済一光導液層と第二体壁層であることを特徴とするものである。

組成をIn_{x1}Ga_{1-x1}As(0≤x1≦1)とし、前配第一および第 二歪障壁層をIn_{x2}Ga_{1-x2}As_{1-y}P_y (0.00≦x2≦0.23, 0.0 4≦y≦0.50)とし、前配第一および第二光導波層をIn_x3G a_{1-x3}As_{1-y}P_y(x2<x3≦0.25)とすることが好ましい。 [0007] 【発明の効果】本発明のIII-V族系半導体レーザでは、

【発明の効果】本発明のIII-V族系半導体レーザでは、 引張り金障壁層により圧縮性歪活性層の歪が補償される ため信頼性の向上が期待できる。

【0008】また、光導液層と引張り強輝壁層とのV族組成比を同一としていることにより、MOCVD法での成長の際、光導液層と引張り重確壁層間でV族水素化物ガスの切換の必要がないために、界面での成長中断時間を短縮することができ、界面に欠陥を発生させずにレーザ構造を作成することができ、また、界面および界面の上に成長する結晶の品質を向上させることができ、結果として素子の信頼性を向上することができる。

[0009]一般に、半導体レーザ作製時の半導体各層の組成を決定するためには図2に示すような組成図 (II 「V 版半導体混晶:コロナ出版)が用いられる。図2には、組成図に合わせて、等バンドギャップ級(実験)、特格子定数線(碳線)各成長温度におけるミシビリティギャップ(一点機線)を示す。例えば、光導液層およびクラッド層はGaAs基板に格子整合する組成比、すなわち等格子定数線0.0%で示される破線上の組成比をとり、そのとり得る範囲は成長温度に依存するミシビリティギャップとの関係で定められる。本発明の半導体レーザにおいては、光導液層と引張り歪躍整層とのV族組成比が2人よ3であることから、図回一であり、III 族組成比が2人よ3であることから、図のとから明らかなように引張り歪躍整層のバンドギャップが光導液層のバンドギャップより高いものとなるため、発光効率および発短関値電減の温度依存性を小さくする発光効率および発短関値電減の温度依存性を小さくする

[0010]

ことができる。

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。

【0011】図1は、本発明の一実施の形態を示すもの

(2)

特朗平10-4237